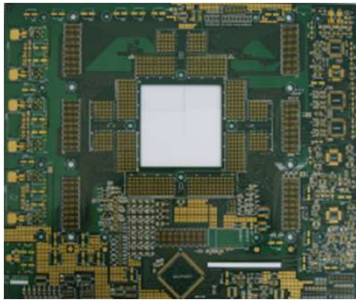


基板製造

(IVH、SVH、ビルドアップ、パットオン、76層板)



- ・ 18層板
- ・ 板厚:4.6t
- ・ 材質:マグネシウム6(低誘電)材
- ・ 660mm × 810mm
- ・ 伝送線路シミュレーション
- ・ 等長配線
- ・ インピーダンスコントロール



- ・ 8層板
- ・ 0.65ピッチBGA搭載
- ・ 伝送線路シミュレーション
- ・ パットオンスルーホール仕様
- ・ インピーダンスコントロール



- ・ 12層板
- ・ パットレイヤー仕様
- ・ コンピュータマザーボード
- ・ FR-5材